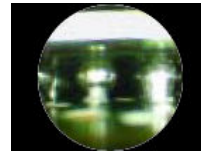


Sondy pro optickou kontrolu zapájení prvků BGA

Tato sonda je jednoduchý, cenově příznivý a efektivní nástroj pro kontrolu kvality pájených spojů pod komponenty namontovanými na povrchu – zejména prvky BGA. Bateriové napájení eliminuje potřebu externího napájení, což činí tento systém opravdu přenosným. Sondu je samozřejmě možno doplnit o další příslušenství jako je digitální fotoaparát, kamera, stojan s pracovní deskou apod.



Podpora programu „Vzdělávejte se!“



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

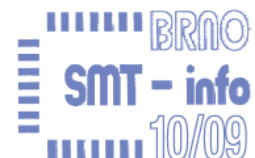


PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Naše společnost je Vám schopna poskytnout školení v rámci programu „Vzdělávejte se! Jde o program pro firmy postižené ekonomickou recesí, což jsou víceméně všechny firmy v elektrotechnickém průmyslu v ČR. V letošním roce je vyčleněno ministerstvem práce a sociálních věcí na tento program více než 1,5 miliardy Kč. Tato školení jsou, v případě splnění jednoduchých administrativních podmínek, plně hrazena úřadem práce, včetně mzdy školených zaměstnanců.

SMT – info Brno 10/09

Dne 20. října pořádá SMT-INFO KONSORCIUM ve spolupráci s FEKT VUT v Brně a SOŠ a SOU informatiky a spojů mezinárodní konferenci na téma:
PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY, OPRAVY V SMT, NOVINKY.



Naše společnost zde bude v rámci programu prezentovat firmu SOLDERCOM a jejich modulární systémy pro selektivní pájení. Bude nám ctí přivítat zástupce firmy SOLDERCOM pana Jochena Elberta.